



江西省某公司集成电路研发中心建设项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

项目名称：江西省某公司集成电路研发中心建设项目可行性研究报告

项目性质：新建项目

项目地点：江西省

项目背景：

从市场需求角度来看，在国内电子信息产业需求拉动和全球集成电路产业进一步向我国转移的共同作用下，未来我国集成电路产业持续向好。据《国家集成电路产业发展推进纲要》，到 2015 年我国集成电路产业销售收入将超过 3,500 亿元。

建设内容：

项目位于公司现有厂区内，利用空余厂地新建研发中 14,330 平方米；改造车间 9,118 平方米。项目所在地目前已建有截污管网，区域内电力、电讯、给排水、交通等基础配套设施齐全。



江西省某公司集成电路研发中心建设项目

项目总投资：

本项目总投资 4,921.51 万元，其中工程建设费 800 万元，装修费 300 万元，

研发设备购置及安装费 3,264.90 万元。

项目结论:

1、经济效益:

本项目建成后,公司将通过引进封装材料领域的高端人才,组建新材料研发室,加强对高品质的新型塑封树脂、装片胶、框架以及高可靠性的合金线、铜带等新型材料的应用研发,达到降低生产成本、提升产品质量的目的,从而进一步提升公司产品的市场竞争力。

2、社会效益:

通过此次研发中心项目的实施,公司不仅能够向研发中心投入更多先进的仪器和设备,还能引进更多的国内外尖端研发人才,加大研究经费的投入力度,增强公司的研发实力,本项目将致力于研发 Flip-Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装技术以满足公司和行业发展的需要。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869